



(株)テクニカルシステムは、
電子機器の開発・設計から製作・製造まで
ものづくりをトータルサポート/お客様のあらゆるニーズにお応えします。

● **工程**



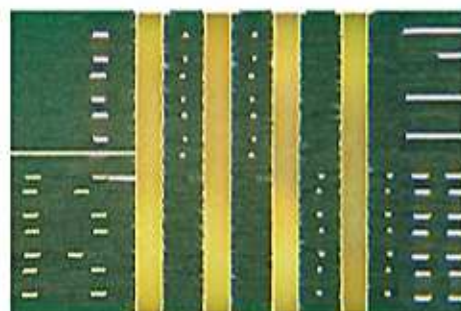
**社内一貫
生産体制**

**多品種
少量生産**

プリント配線基板の**社内一貫生産**が可能な製造設備を有し、**多品種少量生産**を基本として、高密度・高多層プリント配線基板の設計・製造、電子機器商品の開発、実装・組立、性能検査までを行なっております。電子機器の外装にあたる、各種銘板、フィルムシート、パネルケーシング加工等の設計～製作も行い、電子機器開発における総合的なコーディネートを目指しています。

▶ **プリント配線基板製造**

- 層数:片面～30層
- IVH基板、穴埋基板
- 鉛フリー基板
- 特性インピーダンス制御基板
- 厚付電解金メッキ(0.5～1.0 μ m)
- 板厚:0.1～5.0t
- 最小穴径:0.1 ϕ
- 最小サイズ:670x590mm
- L/S:80/80 μ m



▶ **電子機器 実装・組立・性能検査**

- 実装ライン設備保有
鉛フリー半田、共晶半田の双方に対応
- 画像検査機、ファンクションチェッカー、
ICT(インサーキットテスト)対応
- BGA、CSP実装

